精选快讯　金融快讯　2026年11月12日 10:35

三星扩大忠清地区投资至约1080亿美元，用于HBM、OLED和电池枢纽

要点

- 三星集团12日在忠南牙山三星电子温阳园区举行的忠清地区大型项目动工仪式上披露，将当地投资提高至144万亿韩元（约1080亿美元），较7月公布的140万亿韩元计划增加4万亿韩元，并提前主要工厂动工日期。
- 三星电子向温阳和天安投入60万亿韩元建设HBM生产基地，较7月计划增加4万亿韩元。
- 三星显示向牙山和天安投资67万亿韩元，其中牙山A7先进OLED线获5.9万亿韩元（约44亿美元）。
- 三星电机向世宗园区投入8万亿韩元扩大AI服务器先进封装基板产能，其中4.3万亿韩元（约32亿美元）建设地上四层、总建筑面积约3万坪的新工厂；

三星集团12日在忠南牙山三星电子温阳园区举行的忠清地区大型项目动工仪式上披露，将当地投资提高至144万亿韩元（约1080亿美元），较7月公布的140万亿韩元计划增加4万亿韩元，并提前主要工厂动工日期。投资由四家关联公司分担：三星电子60万亿韩元、三星显示67万亿韩元、三星电机8万亿韩元、三星SDI 9万亿韩元。布局以牙山、天安和世宗为中心，同步建设半导体、显示器和电池生产生态。

三星电子向温阳和天安投入60万亿韩元建设HBM生产基地，较7月计划增加4万亿韩元。温阳园区5号线初期投资6万亿韩元；工厂地上三层、总建筑面积约9400坪，生产下一代HBM。为应对服务器内存需求激增，建设日程比原计划提前一年，目前正进行地基工程，目标2028年6月投入运营。

三星显示向牙山和天安投资67万亿韩元，其中牙山A7先进OLED线获5.9万亿韩元（约44亿美元）。A7线总建筑面积约17万坪，生产可折叠设备、平板电脑和笔记本电脑用下一代OLED面板；该线10月开工，目标2029年下半年量产。

三星电机向世宗园区投入8万亿韩元扩大AI服务器先进封装基板产能，其中4.3万亿韩元（约32亿美元）建设地上四层、总建筑面积约3万坪的新工厂；新厂10月开工，目标2028年9月量产，并寻求在附近获取更多土地、扩大投资规模。三星SDI向天安园区投资9万亿韩元，核心是开发下一代电池关键技术并建设验证新生产流程的母工厂；该园区建设已于去年7月完成，设备自去年11月起运行，并仍在引入额外设备。

报道来源：biggo
来源网站：https://www.inews.today/